



## Workshop

### “Metallization & Surface Finishes”



## Programm

**Datum: Mittwoch 17. Februar 2016**

**Ort: Fraunhofer IZM, Berlin, Deutschland**

**Sprache: Deutsch**

- 10:30 Uhr Begrüssung und Einleitung Paul Waldner
- 10:45 Uhr Einleitung Andreas Ostmann, Fraunhofer IZM
- 11:00 Uhr Hofstetter ein führender Dienstleister für die Europäische Leiterplattenindustrie  
*Hansruedi Fischer, Hofstetter PCB AG*
- 11:30 Uhr Aktuelle Trends der Substrat-Technologie: Embedding und Panel-Level Packaging  
Andreas Ostmann, Fraunhofer IZM
- 12:00 Uhr Mittagessen
- 13:00 Uhr Firmenrundgang bei Fraunhofer IZM
- 14:15 Uhr Eine interessante Methode um mit Semi-Additiven und Voll-Additiven Techniken sehr feine Leiterbahnen herzustellen  
*Paul Waldner, Multiline International Europa LP on behalf of e-Surface*
- 14:45 Uhr Beitrag über Haftvermittler (BO-Ersatz, Pre treatment vor Lack bzw. Filmbeschichtung etc.) im Bereich Leiterplattenfertigung  
*Stephan Hotz, Atotech Deutschland GmbH*
- 15:15 Uhr Kaffee-Pause
- 15:45 Uhr Stand der Technik und Neuentwicklungen bei der Durchkontaktierung mit chemisch Kupfer, Übersicht der galv. Kupfer Verfahren  
*Ralf Kälber, DOW*
- 16:15 Uhr System Kupferprozess. Füllen von Durchkontaktierungen durch galvanische Verkupferung  
*Dr. Peter Meeh, MacDermid GmbH*
- 16.45 Uhr ENIG & und neuartige Ni-freie Beschichtungen für zukunftsweisende PCB Endoberflächen  
*Andreas Gross, Umicore Galvanotechnik GmbH*
- 17:15 Uhr Abschluss, Paul Waldner



Fraunhofer IZM,  
host of the EIPC Workshop



The EIPC is the European representative at the WECC



Sustainable Ultra Sonically Enhanced Chemical Processes  
[www.susonence.eu](http://www.susonence.eu)



Maskless Electrochemical Surface Modification Process  
[www.mesmoproc.eu](http://www.mesmoproc.eu)

Sponsored by:



For more information contact EIPC:  
Bourgognestraat 16  
NL-6221 BX Maastricht  
Phone +31-43-34408-72  
E-mail [eipc@eipc.org](mailto:eipc@eipc.org)

Please visit  
[www.eipc.org](http://www.eipc.org)  
for the latest news